BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan yang dilakukan, serta saran yang diberikan untuk menjalankan dan mengembangkan fungsi lebih lanjut.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan pengembangan fungsi baru ini pemeriksaan jarak antar pad dapat dilakukan dengan lebih teliti daripada pemeriksaan yang dilakukan secara manual, sehingga mengurangi tingkat terjadinya *error* pada desain PCB.
2. Dengan menggunakan fungsi yang telah dibangun desainer PCB merasa terbantu dalam melakukan proses verifikasi jarak antar pad komponen sesuai dengan aturan dan meringkas waktu yang diperlukan.

5.2 Saran

Saran yang dianjurkan untuk hasil penilitian ini adalah:

1. Pengaplikasian fungsi pad – pad sebaiknya digunakan sebelum memasuki tahapan menyertakan *ICT, Thermal resist* dan *residual resist guide line*. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya *false error* akibat adanya bentrok dengan komponen komponen diatas tersebut.
2. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan apabila kebutuhan dimasa depan bertambah dengan adanya *Board VD* yang menggunakan dua *layer*. Sehingga membutuhkan *Resist-A* sebagai input pemeriksaan.